

資通訊資安·溯源管理

《提升資通訊及 IC 產業軟體開發資安研討會》10 月底起跑

物聯網 (IoT) 之應用日新月異，經由各式的連網裝置，駭客或有心人士有可能透過裝置上的安全漏洞進而竊取個人隱私資料，甚或威脅關鍵基礎設施的正常運作。而最近幾年發現的案例，諸多是來自晶片資安的問題。

近來，中美貿易戰更凸顯資安議題，從個人資料、企業機密文件層級，拉升到國家安全防衛，讓國際網通大廠與 3C 大廠也開始重視晶片資安與供應鏈安全。

如何確保 IC 設計與開發過程的安全，避免在晶片設計及軟體開發發生資安問題，透過《提升 IC 產業軟體開發資安研討會》將針對晶片安全軟體開發、安全軟體成熟度模型與晶片資安的國際標準進行深度分享。

《提升資通訊及 IC 產業軟體開發資安研討會》由經濟部技術處主辦，委託財團法人資訊工業策進會資安科技研究所執行，預計舉辦三場：10 月 29 日台南場、10 月 30 日台中場、11 月 4 日新竹場。

■ 國際大廠要求供應商導入開發安全流程

1. 近年來陸續發生諸多來自於晶片的安全問題所導致安全事件，例如兒童智慧玩具成了駭客監控家庭活動的最佳工具；手機晶片漏洞讓個人訊息、位置全都露；硬體大廠的韌體漏洞，讓最嚴密的資料庫也因後門程式有洩露危機等等。
2. 愈來愈多的資安事件浮上檯面，不僅事涉個人隱私、企業機密，連國家安全都成問題，讓國際大廠開始對資安需求升級，像是要求晶片設計公司導入安全軟體成熟度模型；或是在供應鏈管理時，要求相關廠商提出產品的軟體開發安全流程做法；不少關鍵基礎設施的採購案，更要求提供的資通訊產品必須通過國際資安標準或評測。

■ 中美貿易戰火下台灣廠商的因應之道在於如何接軌國際安全要求

台灣資通訊產業在國際上佔有重要位置，在客戶提出上述要求前，如何提早做好因應？《提升資通訊及 IC 產業軟體開發資安研討會》將從四大面向進行分享：

- ☑ 趨勢面：資通訊及 IC 設計業軟體的安全議題；
- ☑ 安全面：國際資安標準介紹；
- ☑ 技術面：如何做好安全軟體開發流程；
- ☑ 管理面：如何建立安全軟體成熟度模型。

■ 產業如何推動 BSIMM 安全成熟度模型

會中將介紹 BSIMM 安全軟體成熟度框架及說明企業如何進行軟體安全成熟度自評。

◆ 《提升資通訊及 IC 產業軟體開發資安研討會》議程

時 間	議 程	主講者
13:30~14:00	報 到	
14:00~14:10	貴賓致詞	
14:10~15:00	資通訊及 IC 設計業軟體安全議題 及國際資安標準 IEC62443/FIPS/CC/BSIMM	資策會資安所 安華聯網
15:00~15:20	軟體安全成熟度模型經驗分享	Synopsys
15:20~15:40	休息交流時間	
15:40~16:00	軟體安全成熟度作業說明	資策會資安所
16:00~16:20	安全軟體開發的導入與建置	華苓科技

◆ 研討會報活動日期與地點

台南場：109 年 10 月 29 日 (四) 南科商務會館 201 會議室 (台南市新市區南科三路 26 號 2F) →線上報名請點：<https://chipsecurity.secbuzzer.co/22edm>

台中場：109 年 10 月 30 日 (五) 中科管理局工商大樓 702 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 7F) →線上報名請點：<https://chipsecurity.secbuzzer.co/22edm>

新竹場：109 年 11 月 04 日 (三) 集思竹科會議中心羅西尼廳 (新竹市東區工業東二路 1 號 4F) →線上報名請點：<https://chipsecurity.secbuzzer.co/21edm>

【新聞聯絡人】

資策會資安所	楊小萍	Tel: (02)6607-8984	ysp@iii.org.tw
資策會企推處	顏瑄組長	Tel: (02) 6631-8635	joyyen@iii.org.tw
	沈盈吟	Tel: (02) 6631-8643	yingshen@iii.org.tw